



广东生荣电子实业有限公司

材料成分表 Substances in Product

物料名称Description	型号 (图号) Mode (Drawing number)	材料重量 Material weight (g)	组成原材料名称 Name of Material	物质名称 Substance Name (e. g. Copper (Cu))	CAS No.	物质重量 Substance Mass. (mg)	含量 Content (%)
整流二极管	D0-41	0.244	芯片Diffusion wafer	硅Silicon	7440-21-3	0.6106	>98
				镍Ni	7440-02-0		<0.01
				银Ag	7440-22-4		<2
			焊片Solder wafer	铅 Lead	7439-92-1	1.4116	92.5
				锡Stannum	7440-31-5		5
				银Ag	7440-22-4		2.5
			引线Lead wire	锡Stannum	7440-31-5	198.3	2.15
				铜Copper	7440-50-8		97.85
			白胶Resin	二甲基硅氧烷Dimethyl siloxane		2.05	>60
				石英Quartz	14808-60-7		10-30
				Methylhydrogen siloxane			10
			塑封料Epoxy coating	二氧化硅 SiO ₂	14808-60-7	34.7823	70.58
				环氧树脂Epoxy resin	29690-82-2		14.71
				酚醛树脂BLS (polymer)	9003-35-4		14.71
			镀层Plating	锡Stannum	7440-31-5	6.8455	100